

2024-2030年中国半导体设备行业运营现状及发展前景预测报告

报告大纲

智研咨询

www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2024-2030年中国半导体设备行业运营现状及发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1126120.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

由智研咨询专家团队精心编制的《2024-2030年中国半导体设备行业运营现状及发展前景预测报告》（以下简称《报告》）重磅发布，《报告》旨在从国家经济及产业发展的战略入手，分析半导体设备行业未来的市场走向，挖掘半导体设备行业的发展潜力，预测半导体设备行业的发展前景，助力半导体设备业的高质量发展。

本《报告》从2022年全国半导体设备行业发展环境、上下游产业链、国内外基本情况、细分市场、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国半导体设备行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国半导体设备行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国半导体设备行业发展状况的著作，对于全面了解中国半导体设备行业的发展状况、开展与半导体设备行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事半导体设备行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。

半导体设备是指用于生产各类型集成电路与半导体分立器件的专用设备，具有产品种类多、技术要求高、制造难度大、设备价值高、行业壁垒深厚的特点。在整个集成电路制造和封测过程中，一个芯片的生产会经过上千道工序，可以划分出百种不同的机台。根据制造流程，可以将其分为前道的晶圆制造设备与后道封测设备。前道设备主要包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等；后道设备主要包括划片机、贴片机等，前道设备的市场规模占整个设备市场规模的80%以上。

受益于PC和智能手机的普及,中国大陆成为全球电子制造中心，大陆半导体产业开始加速发展。半导体产业向大陆转移的趋势加强。近年来中国大陆地区半导体设备需求规模占全球市场份额出现明显提升。中国大陆半导体设备市场在 2013 年之前占全球比重小于10%，2014-2017 年提升至 10-20%，2018 年之后保持在 20%以上，2022年中国大陆在全球市场占比实现 26.3%，连续3年成为全球最大半导体设备市场。近年来，随着中国对半导体产业的高度重视，中国部分半导体专用设备企业经过了十年以上的技术研发和积累，在部分技术领域陆续取得了突破，成功地通过了部分集成电路制造企业的验证，成为了制造企业的设备供应商。近年来我国半导体设备企业销售额呈现较快增长态势。

中国半导体设备发展起步相对较晚，自2000年以来才正式起步，经过20余年的培育与发展，已经有不少如晶盛机电、北方华创、中微半导体、电科装备、屹唐半导体等一批企业成为在全球市场上具有一定竞争力的企业，追赶步伐不断加快。目前，国内半导体专用设备生产企业规模较大的超过40家，北京、上海、浙江、广东是国内半导体设备企业主要分布地区。受益于强有力的国家战略支持，密集的资本和人才投入，起步较晚的本土半导体设备上市公司在国产替代的重大机遇下，2022年业绩迎来快速增长，增速普遍高于国际半导体设备巨头。

随着中美贸易摩擦的加速，半导体全供应链国产化势在必行。在需求拉动和国产替代浪潮的推动下，伴随着国家鼓励类产业政策和产业投资基金不断的落实与实施，如加大资金支持、出台税收优惠政策、加强知识产权保护等，这些都助于半导体设备市场的持续发展，半导体设备行业迎来巨大的发展契机。未来几年我国半导体设备行业仍将保持高速增长。未来半导体设备技术发展趋势主要有以下几个方面：

《2024-2030年中国半导体设备行业运营现状及发展前景预测报告》是智研咨询重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是矿山机械领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

报告目录：

第一章 半导体设备行业基本概述

第一节 半导体的定义和分类

- 一、半导体的定义
- 二、半导体的分类
- 三、半导体的应用

第二节 半导体设备行业概述

- 一、行业概念界定
- 二、行业主要分类

第二章 2019-2023年中国半导体设备行业发展环境PEST分析

第一节 政策环境（POLITICAL）

- 一、半导体设备政策汇总
- 二、半导体制造利好政策
- 三、集成电路企业税收优惠
- 四、集成电路产业政策扶持
- 五、产业投资基金的支持

第二节 经济环境（ECONOMIC）

- 一、宏观经济发展概况
- 二、工业经济运行情况
- 三、经济转型升级发展
- 四、未来经济发展展望

第三节 社会环境 (SOCIAL)

- 一、电子信息产业增速
- 二、电子信息设备规模
- 三、研发经费投入增长
- 四、科技人才队伍壮大

第四节 技术环境 (TECHNOLOGICAL)

- 一、企业研发投入
- 二、技术迭代历程
- 三、企业专利状况

第三章 2019-2023年半导体产业链发展状况

第一节 半导体产业链分析

- 一、半导体产业链结构
- 二、半导体产业链流程
- 三、半导体产业链转移

第二节 2019-2023年全球半导体市场总体分析

- 一、市场销售规模
- 二、行业产品结构
- 三、区域市场格局
- 四、产业研发投入
- 五、市场竞争状况
- 六、企业支出状况
- 七、产业发展前景

第三节 2019-2023年中国半导体市场运行状况

- 一、产业发展历程
- 二、产业销售规模
- 三、市场规模现状
- 四、产业区域分布
- 五、市场机会分析

第四节 2019-2023年中国IC设计行业发展分析

- 一、行业发展历程
- 二、市场发展规模
- 三、企业发展状况
- 四、产业地域分布
- 五、专利申请情况

六、资本市场表现

七、行业面临挑战

第五节 2019-2023年中国IC制造行业发展分析

一、制造工艺分析

二、晶圆加工技术

三、市场发展规模

四、企业排名状况

五、行业发展措施

第六节 2019-2023年中国IC封装测试行业发展分析

一、封装基本介绍

二、封装技术趋势

三、芯片测试原理

四、市场发展规模

五、芯片测试分类

六、企业排名状况

七、技术发展趋势

第四章 2019-2023年半导体设备行业发展综合分析

第一节 2019-2023年全球半导体设备市场发展形势

一、市场销售规模

二、市场结构分析

三、市场区域格局

四、重点厂商介绍

五、厂商竞争格局

第二节 2019-2023年中国半导体设备市场发展现状

一、市场销售规模

二、市场需求分析

三、企业竞争态势

四、企业产品布局

五、市场国产化率

六、行业发展成就

第三节 半导体产业核心设备——晶圆制造设备市场运行分析

一、设备基本概述

二、核心环节分析

三、主要厂商介绍

四、厂商竞争格局

五、市场发展规模

第四节 半导体产业核心设备——晶圆加工设备市场运行分析

一、设备基本概述

二、市场发展规模

三、市场价值构成

四、市场竞争格局

第五节 半导体设备行业财务状况分析

一、经营状况分析

二、盈利能力分析

三、营运能力分析

四、成长能力分析

五、现金流量分析

第五章 2019-2023年半导体光刻设备市场发展分析

第一节 半导体光刻环节基本概述

一、光刻工艺重要性

二、光刻工艺的原理

三、光刻工艺的流程

第二节 半导体光刻技术发展分析

一、光刻技术原理

二、光刻技术历程

三、光学光刻技术

四、EUV光刻技术

五、X射线光刻技术

六、纳米压印光刻技术

第三节 2019-2023年光刻机市场发展综述

一、光刻机工作原理

二、光刻机发展历程

三、光刻机产业链条

四、光刻机市场规模

五、光刻机竞争格局

六、光刻机技术差距

第四节 光刻设备核心产品——EUV光刻机市场状况

一、EUV光刻机基本介绍

- 二、典型企业经营状况
- 三、EUV光刻机需求企业
- 四、EUV光刻机研发分析

第六章 2019-2023年半导体刻蚀设备市场发展分析

第一节 半导体刻蚀环节基本概述

- 一、刻蚀工艺介绍
- 二、刻蚀工艺分类
- 三、刻蚀工艺参数

第二节 干法刻蚀工艺发展优势分析

- 一、干法刻蚀优点分析
- 二、干法刻蚀应用分类
- 三、干法刻蚀技术演进

第三节 2019-2023年全球半导体刻蚀设备市场发展状况

- 一、市场发展规模
- 二、市场竞争格局
- 三、设备研发支出

第四节 2019-2023年中国半导体刻蚀设备市场发展状况

- 一、市场发展规模
- 二、企业发展现状
- 三、市场需求状况
- 四、市场空间测算
- 五、市场发展机遇

第七章 2019-2023年半导体清洗设备市场发展分析

第一节 半导体清洗环节基本概述

- 一、清洗环节的重要性
- 二、清洗工艺类型比较
- 三、清洗设备技术原理
- 四、清洗设备主要类型
- 五、清洗设备主要部件

第二节 2019-2023年半导体清洗设备市场发展状况

- 一、市场发展规模
- 二、市场竞争格局
- 三、市场发展机遇

四、市场发展趋势

第三节 半导体清洗机领先企业布局状况

- 一、迪恩士公司
- 二、盛美半导体
- 三、至纯科技公司
- 四、国产化布局

第八章 2019-2023年半导体测试设备市场发展分析

第一节 半导体测试环节基本概述

- 一、测试流程介绍
- 二、前道工艺检测
- 三、中后道的测试

第二节 2019-2023年半导体测试设备市场发展状况

- 一、市场发展规模
- 二、市场竞争格局
- 三、细分市场结构
- 四、设备制造厂商
- 五、主要产品介绍

第三节 半导体测试设备重点企业发展启示

- 一、泰瑞达
- 二、爱德万

第四节 半导体测试核心设备发展分析

- 一、测试机
- 二、分选机
- 三、探针台

第九章 2019-2023年半导体产业其他设备市场发展分析

第一节 单晶炉设备

- 一、设备基本概述
- 二、市场发展现状
- 三、企业竞争格局
- 四、市场空间测算

第二节 氧化/扩散设备

- 一、设备基本概述
- 二、市场发展现状

三、企业竞争格局

四、核心产品介绍

第三节 薄膜沉积设备

一、设备基本概述

二、市场发展现状

三、企业竞争格局

四、市场前景展望

第四节 化学机械抛光设备

一、设备基本概述

二、市场发展规模

三、市场竞争格局

四、主要企业分析

第十章 2019-2023年国外半导体设备重点企业经营状况

第一节 应用材料 (APPLIED MATERIALS, INC.)

一、企业发展概况

二、企业发展历程

三、企业经营状况

四、企业核心产品

五、企业业务布局

六、企业发展前景

第二节 泛林集团 (LAM RESEARCH CORP.)

一、企业发展概况

二、企业经营状况

三、企业核心产品

四、企业发展前景

第三节 阿斯麦 (ASML HOLDING NV)

一、企业发展概况

二、企业发展历程

三、企业经营状况

四、企业核心产品

五、企业发展前景

第四节 东京电子 (TOKYO ELECTRON, TEL)

一、企业发展概况

二、企业经营状况

三、企业核心产品

四、企业发展前景

第十一章 国内半导体设备重点企业经营状况分析

第一节 浙江晶盛机电股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、核心竞争力分析

第二节 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、核心竞争力分析

第三节 中微半导体设备（上海）股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、核心竞争力分析

第四节 北方华创科技集团股份有限公司

一、企业发展概况

三、业务经营分析

二、经营效益分析

四、财务状况分析

五、核心竞争力分析

第五节 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、核心竞争力分析

第六节 北京华峰测控技术股份有限公司

- 一、企业发展概况
- 二、经营效益分析
- 三、业务经营分析
- 四、财务状况分析
- 五、核心竞争力分析

第七节 中电科电子

- 一、企业发展概况
- 二、企业核心产品
- 三、企业参与项目
- 四、产品研发动态
- 五、企业发展前景

第八节 上海微电子

- 一、企业发展概况
- 二、企业发展历程
- 三、企业参与项目
- 四、企业创新能力
- 五、企业发展地位

第十二章 半导体设备行业投资价值分析

第一节 半导体设备企业并购市场发展状况

- 一、企业并购历史回顾
- 二、行业并购特征分析
- 三、企业并购动机归因
- 四、国内企业并购动态

第二节 中国半导体设备市场投资机遇分析

- 一、整体投资机遇分析
- 二、建厂加速拉动需求
- 三、产业政策扶持发展

第三节 半导体设备行业投资机会点分析

- 一、薄膜工艺设备
- 二、刻蚀工艺设备
- 三、光刻工艺设备
- 四、清洗工艺设备

第四节 半导体设备行业投资壁垒分析

- 一、技术壁垒分析

二、客户验证壁垒

三、竞争壁垒分析

四、资金壁垒分析

第五节 半导体设备行业投资风险分析

一、经营风险分析

二、行业风险分析

三、宏观环境风险

四、知识产权风险

五、人才资源风险

六、技术研发风险

第六节 半导体设备投资价值评估及建议

一、投资价值综合评估

二、行业投资特点分析

三、行业投资策略建议

第十三章 中国行业标杆企业项目投资建设案例深度解析

第一节 半导体湿法设备制造项目

一、项目基本概述

二、资金需求测算

三、建设内容规划

四、经济效益分析

五、项目基本概述

六、资金需求测算

七、实施进度安排

八、经济效益分析

第二节 光刻机产业化项目

一、项目基本概述

二、资金需求测算

三、建设内容规划

四、经济效益分析

第三节 半导体设备产业化基地建设项目

一、项目基本概述

二、资金需求测算

三、项目进度安排

四、项目投资价值

第十四章 2024-2030年中国半导体设备行业发展趋势及预测分析

第一节 中国半导体产业未来发展趋势

- 一、技术发展利好
- 二、自主创新发展
- 三、产业地位提升
- 四、市场应用前景

第二节 中国半导体设备行业发展前景展望

- 一、政策支持发展
- 二、行业发展机遇
- 三、市场应用需求
- 四、行业发展前景

第三节 2024-2030年中国半导体设备行业预测分析

- 一、2024-2030年中国半导体设备行业影响因素分析
- 二、2024-2030年中国大陆半导体设备销售规模预测

图表目录：部分

图表1：半导体设备分类

图表2：2019-2023年全球半导体市场销售额

图表3：2019-2023年全球半导体销售额区域分布情况

图表4：2019-2023年中国半导体产业规模

图表5：2019-2023年中国集成电路销售收入及细分情况

图表6：2019-2023年全球半导体设备销售额

图表7：2023年全球半导体设备产品销售区域格局

图表8：2023年全球半导体设备十大厂商及其相关业务营收统计

图表9：2019-2023年中国半导体器设备行业销售平衡情况

图表10：2019-2023年中国半导体设备行业细分领域销售收入情况

图表11：中国各类半导体设备主要参与者

图表12：2019-2023年中国半导体设备国产化率水平

图表13：2019-2023年中国半导体设备企业销售额

图表14：2023年中国半导体设备厂商及其相关业务营收统计

图表15：2019-2023年中国晶圆生产设备市场规模情况

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1126120.html>